Partial English Translation for JP62-21751

Japanese Patent Application Laying-open No. 62-21751

Publication Date: January 30, 1987

Applicant: Showa Denko K.K.

1. Title of the Invention

${\rm In_2O_3\text{-}SnO_2}$ SINTERED BODY AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

- 2. Scope of Claims
- (1) In₂O₃-SnO₂ sintered body characterized in that particle diameters of crystals are substantially in a range of 2 μ m to 15 μ m,

an average particle diameter of the crystals is between 4 μm and 7 μm , and

apparent relative density of the sintered body is not less than 4.5.

(2) A method of manufacturing In₂O₃-SnO₂ sintered body whose apparent relative density is not less than 4.5, the method characterized by comprising the steps of:

obtaining a calcinated mixed powder in which an In₂O₃ powder and a SnO₂ powder are mixed with each other, at least the In₂O₃ powder being calcinated at a temperature between 1200 °C and 1450 °C;

subsequently grinding the mixed powder so as for particle sizes of the mixed powder to be between 3 μ m and 6 μ m in d₅₀ (median value);

forming the resultant mixed powder in a shape; and sintering the shape.

3. Detailed Description of the Invention

Industrial Applicability

The present invention relates to In₂O₃-SnO₂ (hereinafter referred to as ITO) sintered body and a method of manufacturing the same.

9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-21751

(i) Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)1月30日

C 04 B 35/00

7412-4G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

砂発明の名称

IngOz-SnOz焼結体及びその製造法

❷特 顧 昭60-160070

❷出 願 昭60(1985)7月22日

の発明者 清 興の発明者 坂井田 敏

飯 昭

至

塩尻市大字宗賀1 塩尻市大字宗賀1 昭和電工株式会社塩尻研究所内昭和電工株式会社塩尻研究所内

70発 明 者 平 岩 正 70発 明 者 籠 田 政 博 塩尻市大字宗賀 1

昭和電工株式会社塩尻研究所内

⑪出 願 人 昭和電工株式会社

塩尻市大字宗賀1

昭和電工株式会社塩尻研究所内

® 八 哈和电工休式会在 ®代理人 力理士菊地 精一 東京都港区芝大門1丁目13番9号

明 加 雷

1. 危明の名称

In203-8n02端結体及びその製造法

- 2.特許請求の範囲
- (1) 結晶粒径が実質的に 2~15μm の範囲にあり、かつ平均結晶粒径が 4~7 μm からなり、見掛比重が、 4.5以上である1n203-Sa02協結体。
- $\{2\}$ $1n_2O_3$ 粉末と SnO_2 粉末のうち少なくとも $1n_2O_3$ 粉末を $1200\sim1450$ ℃で仮挽した福合粉末を得、次いで粉砕して混合粉末の粒度を d_{50} (中央値) で $3\sim8$ μ = とし、これを成形、焼破することを特徴とする見掛比重が 4.5以上である $1n_2O_3$ - SnO_2 焼 結体の製造法。
- 3 . 発明の詳細な説明

(イ) 産業上の利用分野

木 晃 明 は i n ₂ O g - S n O ₂ (以下、 i t O と い う) 焼 結 体 及 び そ の 製 造 法 に 関 す る 。

被基表示案子透明電板に 170週明電極が使われている。 170週明電極を付ける方法として、電子ピーム加熱法、スパッタリング法がある。その基

ガ材として ITO焼結体が供せられている。

(ロ)従来の技術

従来 170 始結体は $1n_20_3$ 粉末と $5n0_2$ 粉末を混合し、成形、 統結してつくられている。混合剤合は合业に対し $5n0_2$ が $3\sim25$ 重量 9 が一般に用いられている。この範囲が電気抵抗が低いからである。

一般に前版している ${\rm In_2O_3}$ 、 ${\rm SnO_2}$ には ${\rm Na.}$ K. Ci、 ${\rm NO_3}$ 等のイオンが微量含まれていることが多く、これは歳形後の焼成では揮発しにくい。

(ハ)発明が解決しようとする問題点

従来のように市販のIn₂0₃ 等には上記のように不能物が含まれており、これらの不能物を含む獲費股は低気抵抗が高いという欠点がある。そこで本発明者は別に成形前に粉末を加熱して不能物を除去する方法を提案した。

さらに、 携着において必要なことは焦存股の厚さが均一に なるためには ITO 統結体が均一に平面を保ちながら前結していくことである。またこのことは焼鉛体の利用率向上にもなる。

市服の1m20g 、SnO2粉末は過常敷集粒となって

いるので、軽く効率して何々の粒にして使用されるが、それでは焼結体の平均の結晶径は 2~3 μα となり、焼結体の密度が上らず、また均一消 純にならない。また粉末を仮焼したものは不純物 の低下には役立つが、粉末の粒度を調整しないと 焼結体の密度が十分上らず、均一消耗の点でも十 分とは云えない。

(二) 間随点を解決するための手段

本発明者は種々研究した結果、焼結体の消耗を 均一にするためには焼結体の密度を高くし、かつ 焼結体を構成する結晶粒の大きさが特定の範囲に あることが必要であることを発見した。そのため には粉末を仮焼後粉砕し、特定の粒度にしたもの を成形焼成することである。

即ち、本発明は焼結粒径(直径)を実質的に*数* 2~15 μ m の範囲とし、がつその結晶の平均径が 4~7 μ m からなっており、しかも焼結体の見掛比重が 4.5 以上である In 20g-Sn 0 g 焼結体である。

またその製法は[n₂0₃ , SnO₂粉末のうち、少なくとも[n₂O₃ の方は予じめ粉末で1200~1450℃で

で、紹合粉末のうち $\ln_2 0_3$ を仮焼しておけばほぼ目的は達成できる。勿論、 $\ln_2 0_3$ 、 $\operatorname{Sn} 0_2$ 国者を保施すればなお望ましいことは云うまでもない。両者を仮焼する場合は紹合後保焼してもよい。

原料粉末は、通常效集性となっているので仮焼 前に軽く粉砕する。粉砕は不純物に汚臭されない ように例えば樹脂ライニング容器で同じく樹脂製 のボールを使用したボールミルで行なう。粉末状 恋で仮焼することにより仮焼中に不純物が抜け易いばかりでなく、次の粉砕工程での粒度調整が容 易となる。

仮能はセラミック質の回鉢に粉末を入れ、1200~1450℃に加熱して行なう。この程度が1200℃未満では不純物の母発が不十分であり、また1450℃を越えると粉末の結晶粒径が大きく、これを用いた次の粉砕工程での粒度調節が容易でない。

仮焼の雰囲気は超元性でなければ、特に限定されず、大気中でもよい。仮焼時間は 5~20時間が 適当である。 仮焼した駅料を使用し、次にこれを粉砕し、d 50 (中央値)が 3~6 μ m の範囲とし、これを成 形、焼成する方法である。

170統結体の結晶の平均粒径が(μm より小さいと機結体の密度が上らず、また 7μm を越えると地結体の無衡整特性が悪くなる。また平均粒径がこの範囲にあっても全体の粒度の分布が広いと焼結体の熱衝撃特性が悪くなるので、全体の粒度は実質的に 2~15μm の範囲に納っていることが必要である。

焼箱体の比重は高い提前耗が遅く、また均一指 純の点でも望ましいことは云うまでもないが、 4.5以上あれば実用上十分である。

次に製造法の発明について説明する。

原料粉末Kである $\ln_2 0_3$ 、 $\sin_2 0_3$ うち少なくとも $\ln_2 0_3$ は粉末で仮焼する。仮焼は一つには前記したような不練物を揮散させること、その二は次の粉砕での粒度異常を容易にするためである。 if 0焼新体は $\ln_2 0_3$ が主体をなしており、不純物の量、粒度特性も殆んど $\ln_2 0_3$ によって定まるの

便施したものは解砕後粉砕する。粉砕は不純物が入らないよう前起原料の粉砕间様樹脂ポットを人れて粉砕する。この粉砕では仮焼によってゆるく結合し塊体となっているものを解砕して個々の枝子とすること及び粒子自体が大き過ぎる場合はこれを粉砕する。この解砕は容易であるが、 拉内酸砕は容易でないので破砕条件を過酷にしたり、長時間粉砕等の手段を採ることが必要である。

粉砕して得た粉末は次に成形、焼成工程に移す。成形は粉末に PVA、 PBC等の一次結合材水溶液を少を加えて凝構し、企型に入れ加圧下で行なうが、 圧力が均等にかかるようにラバープレスにより行なうこともできる。圧力はいずれの場合も 1~2 トンノ cm おれば十分である。

成形化は1000~1400℃程度で焼成して焼結体と

する。 焼結は加圧下で行なうことも可能であるが、 常圧でも十分な強度、耐熱衝象性の焼結体が得られる。 焼成の雰囲気は前記仮焼同様大気中でよい。

このようにして得られた焼結体はその結晶の平均径が 4~7 μm の範囲にあり、そして実質的に結晶径は 2~15 μm の範囲内にある。また焼結体の見掛比重は 4.5以上である。

(ホ) 実施例

樹脂製ポットに市販の[m20g 及び5m02を入れ. 気 同姓のボールで0.5 時間混合物砕した。Sn02の是 は合量に対し 5重量%である。

この語合物をAi203 質匹鉢に移し、大気中1400 でで15時間仮焼した。得られたものは容易に解砕できる程度の塊体であった。

第 1 安

		仮焼温度	仮焼後の粉砕	左の粉砕後の粒度 1 μa 以下、d ₅₀ 、d _{Top}
実施例		1400 °C	20Hz	34% 5 μm 30 μm
比較例	1	なし	-	70% < 1 µ = 8 µ =
图	2	1100 10	20Hr	45% 3 μm 24 μm
[8]	3	1500 °C	なし	17% 8 µm 192 µm

この比較例の効果を用いて、実施例と同様にして焼結体を得た。これらの実施例、比較例の特性を第2次に示す。

郑 2 波

		焼結体の結 分 布 範 囲		地路体の見掛比重
 変施例		2~15	5	4.9
比較例	1	1.0~2.0	1.5	3.7
珂	2	1.0~8	3	1.0
[H]	3	2~20	8	4.6

この粉末に少量の PVA (ポリビニルアルコール) 水溶液を添加、混合した後、金型に入れ、、1トン/ cm'の圧力下で成形した。成形体の大きさはជ径 4インチ、厚さ5インチである。

成形体を上記と同じ壁林に入れ、1300℃、 2時間、大気中で挽収した。

比較のため、上記において In20g-Sn02混合物末を粉砕のみで仮焼しないもの(比較例 1)、 仮焼 温度を 1400での代りに 1100でにしたもの(比較例 2)、その外は実施例 1 と阿禄の方法で焼結体を 個た。

また上記で1600℃の代りに1500℃とし、かつ得られたものは解砕するのみで、粉砕を行なわなかった。その他は同様である(比較例3)

このようにして得られた坡形前の粉末の特性を 実施例と併せて第1次に示す。

(以下余白)

これらの焼結体をターゲットにしてスパッタリングによってガラスな板上に ITO膜をつけ、その特性を測定した。

(a) スパッタリング条件

到達真空压	5 × 10 * 5 arr
スパッタガス	år(5N)
スパッタ圧	5×10^{-3} for r
スパック出力	200 W
uf AA	15 分
ガス焦板温度	名型

(b) 膜特性

			ण स्थ	光透過率	记気抵抗
			(400	~ 700nm)	(Q • cm)
			(ガラス)	花板込み)	
¥	施(F()	. 6	30	8.5×10 ⁻⁴
lt	較(7 ()	. 1	78	2.1×10 ⁻³
	间	2	: 6	30	1.8×10 ⁻³
	[17]	3		0	9.4×10 ⁻⁴

上記のように比較例1、2のものは電気抵抗が 高く、また消耗も不均一であった。比較例3は電 気抵抗は低いが、スパッタ出力 300 Wにすると ターゲットに鬼裂が生じた。

(へ) 発明の効果

In20g-Sn0g焼結体中の結晶粒径を特定範囲に関数し、見掛比低を上げることにより、これから優れた特性の皮膜を得ることができる。またこの焼結体は原料粉末の仮焼、粉末の粒度調整により容易に製造することができる。

特許也顧人 解和電工株式会社 代 理 人 弁理士 菊地精一 乔 統 補 正 鲁(自嘉)

昭和80年 8月23日

特許庁長官 字實 遊邸 殴

1. 本件の表示

昭和80年特許顯第180070号

2. 発明の名称

In203-Sn02機結体及びその製造法

3.補正をする者

诉件との関係 特許出願人

住所 東京都港区芝大門一丁目13番 8号

名称 (200) 昭和電工株式会社

代褒者 洚 本 泰 廷

4. 代理人 (郵便番号 108)

居所 東京福港区芝大門一丁目13番 9 5

昭和電工株式会社内

電話 東京 432-5111番 (大代表)

氏名 (7037) 弁理士 菊 地 精

方式 (客套

5 . 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄。

6. 補正の内容

明細書第 2頁第 8行目に「Ci」とあるのを 「Ci」と訂正し、「NOg」の次に「、SO₄」 を加入する。